

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2026-074

神通科技集团股份有限公司

关于对外投资进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、对外投资基本情况

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月23日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，公司拟在上海临港新片区投资建设“汽车零部件智能制造项目”。该项目将由全资子公司上海鸣羿汽车部件有限公司作为实施主体，项目总投资额预计为人民币7亿元（最终以项目建设实际投资为准）。具体内容详见公司于2026年6月24日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的《关于对外投资的公告》。

二、对外投资进展情况

近日，公司与中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会、上海市奉贤区四团镇人民政府完成投资协议的签署。

公司将持续跟进投资进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定及时披露相关进展。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2026年7月15日